

ポリイミドワニス

Polyimide Varnish

ピバール™ / PIVAR™

用途例：Application Examples

- 耐熱接着剤 / High heat-resistant adhesive materials
- 半導体製造プロセス部材 / Semiconductor manufacturing process materials
- 絶縁被覆材 / Insulation covering materials



[使用方法 / Usage examples of PIVAR]

- フィルムの熱圧着
Thermocompression bonding
- コーティング
Coating
- バインダー樹脂として混合
Additives for binder resin



イミド化が完了したワニスです。
Polyimide varnish



PETフィルム上でフィルム化できます。
Making PI Film on PET film

特長：Characteristics

- 易成膜性 イミド化が完了しているワニスです。 / Easy to make PI film
- 低温乾燥性 150~250℃の乾燥温度です。 / Low temperature film formation
- 優れた柔軟性 しなやかなフィルムが作れます。 / Good flexibility
- 高い絶縁性 ポリイミドの絶縁性を維持しています。 / Outstanding insulation properties

	溶剤*1 Solvent	濃度 Solid content (wt%)	E型粘度 E-type viscosity (mPa·s@25℃)
PIVAR™ Varnish	NMP+TMB	10~25	5,000~30,000

*1: N-methyl-2-pyrrolidone, Trimethylbenzene

PIVAR™ Film	TMA		TGA	引張強度 Mechanical properties		吸水率*4 Water absorption (%)
	Tg (℃)	CTE*2 (10 ⁻⁶ /K)	Td5 (℃)	Tensile modulus (GPa)	Tensile strength (MPa)	
MP14C	139	148	355	1.4	66	0.4
MP17A	165	92	341	2.0	76	0.6
MP20A	204	46	565	3.8	149	1.2
A社ポリイミド 一般的銘柄 Conventional PI	ND	25~30	>500	>3	330~380	1.5~3
測定法 Method	DMA (tan δ)	TMA 5℃/min@Air	TGA 10℃/min@Air	MCI method		RT/24Hr

*2: MP14C: 50~100℃ MP17A: 50~120℃ MP20A: 50~180℃

表中の数値は代表値であり、規格値ではありません。

※記載内容は現時点で入手できた資料、情報、データ等に基づき作成しておりますが、記載のデータや評価に関しては、いかなる保証をするものではありません。

The information contained in this brochure is, to the best of our knowledge, accurate and reliable. But all suggestions are made without warranty, either express or implied. The values relevant to properties or the like of the product stated herein were obtained using laboratory test specimen prepared in Mitsui Chemicals, Inc.